

【复合导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点:

- 柔软, 低出油, 可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐:

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件: 阴暗处储存

储存温度: $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度: $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层, 而且总高度不超过1M

保质期:

在储存条件下: 2 年

不符合储存条件下: 6 个月

TP-H800LY 导热硅胶垫片, 是一款柔软性好, 低出油, 超高导热的热界面材料。产品具有良好的电气绝缘特性及耐高温性能, 并具有高拉伸及高撕裂强度。产品自然粘性和防火性能高, 能够很好地填充间隙, 实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性, 是一种极佳的导热填充材料, 被广泛应用于新能源产品中。

产品性能

NO.	参数	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度 (mm)	0.5~6	ASTM D 374
硬度 (Shore C)	25~55(± 5)	ASTM D 2240
密度 (g/cc)	3.4(± 0.3)	ASTM D 792
拉伸强度 (Mpa)	$\geq 0.1_{(@SC35/1mm)}$	ASTM D 412
延伸率 (%)	$\geq 60_{(@SC35/1mm)}$	ASTM D 412
出油率 (%)	≤ 1	HFC
油径比 (%)	≤ 103	HFC
撕裂强度 (N/mm)	≥ 0.35	ASTM D 624
阻燃等级	V-0	UL-94
使用温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-40~125	IEC 60068-2-14

电学特性

击穿电压 (KV)	$\geq 6_{(@1mm)}$	ASTM D 149
体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	$\geq 10^{10}$	ASTM D 257
介电常数 (@1MHz)	≥ 5	ASTM D 150
介质损耗 (@1MHz)	≤ 0.1	ASTM D 150

热学特性

导热系数 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)	8.0(± 0.5)	ASTM D 5470
热阻 ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{in}^2/\text{W}$)	$\leq 0.27_{(@20\text{Psi}/1mm)}$	ASTM D 5470

热阻 VS 压力(T=1mm SC35供参考)

压力 (Psi)	10	20	30	40	50
热阻 ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{in}^2/\text{W}$)	0.252	0.220	0.196	0.180	0.161
压缩量 (%)	13.88	21.65	30.29	38.25	46.02

以上数据由实验室提供, 该实验室保留最终解释权